

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 登録実用新案公報(U)

(11) 実用新案登録番号

実用新案登録第3179457号
(U3179457)

(45) 発行日 平成24年11月1日(2012. 11. 1)

(24) 登録日 平成24年10月10日(2012. 10. 10)

(51) Int. Cl. F 1
 F 2 1 S 2/00 (2006. 01) F 2 1 S 2/00 1 0 0
 H 0 1 L 33/00 (2010. 01) H 0 1 L 33/00 J
 F 2 1 Y 101/02 (2006. 01) H 0 1 L 33/00 L
 F 2 1 Y 101:02

評価書の請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 実願2012-5135 (U2012-5135)
 (22) 出願日 平成24年8月22日(2012. 8. 22)
 (31) 優先権主張番号 100219001
 (32) 優先日 平成23年10月11日(2011. 10. 11)
 (33) 優先権主張国 台湾(TW)

(73) 実用新案権者 511225114
 柏友照明科技股▲分▼有限公司
 台湾新北市林口區文化二路二段3 6 9號3
 樓
 (74) 代理人 100104215
 弁理士 大森 純一
 (74) 代理人 100117330
 弁理士 折居 章
 (74) 代理人 100123733
 弁理士 山田 大樹
 (74) 代理人 100168181
 弁理士 中村 哲平
 (74) 代理人 100168745
 弁理士 金子 彩子

最終頁に続く

(54) 【考案の名称】 ランプモジュール

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 別途に駆動回路を使用することなく単一のモジュールとして製造できるランプモジュールを提供する。

【解決手段】 カバー構造Cは、カバー本体C1と、カバー本体の底部に設けられる複数の位置付けエレメントC2と、カバー本体の底部に設けられる複数の係止エレメントC3と、を含む。カバー本体は、貫通開口C10と、貫通開口の内表面に形成される圍繞状反射面C11と、を備える。回路基板構造Pは、カバー本体の底部に設けられる。マルチチップパッケージ構造Mは、カバー本体の底部に設けられると共に回路基板構造Pに電氣的に接続される。回路基板構造とマルチチップパッケージ構造をカバー構造の底部から順に組み立てる場合、マルチチップパッケージ構造は圍繞状フレーム樹脂体から露出するため、カバー本体の圍繞状反射面C11により最良な集光効果を奏することができる。

【選択図】 図1 B

